2024 年 10 月 30 日

芝浦メカトロニクス株式会社

ハイエンドウェーハレベルパッケージボンダ「TFC-6600」を開発

芝浦メカトロニクス株式会社は、このたびハイエンドウェーハレベルパッケージボンダ「TFC-6600」を開発し、販売を開始しました。

スマートフォン、PC などに用いられるアプリケーションプロセッサは高密度な配線ピッチが求められています。

このため、Fan Out-Wafer Level Package の高精度化およびチップ間の接続においてブリッジ接続の登場により、高精度な Face Up 実装の必要性が高まっています。

これらの市場要求を「TFC-6600」の「高精度 Face Up 実装」、「高生産性」で実現し更なる販売拡大を目指しています。

□製品概要　ハイエンドウェーハレベルパッケージボンダ　TFC-6600

□特　長

【高精度実装】

・Face Up 精度±2μm（3σ）を実現

・装置の高剛性化による精度安定性の向上

【高生産性】

・Dry UPH 5000 以上の高スループットを実現

【その他機能】

・Multi Die 実装

・クリーン度 Clean Class100（米国連邦規格）

・当社独自の突上技術で薄チップピックアップ時のチップダメージ最小限化

・Adhesive Sheet、DAF に対応

【お問い合わせ先】
芝浦メカトロニクス株式会社
メカトロニクスシステム事業部
https://www.shibaura.co.jp/inquiry/index.html